

Ionenstrahlätzsystem



Ionen-Böschung-Ätzanlage EM TIC 3X der Leica Mikrosystems GmbH

- Nahezu artefaktfreie Oberflächenpräparation an festen Materialien für die mikroskopische Analyse (Lichtmikroskop, Rasterelektronenmikroskop)
- Kein Verschmieren oder Wegbrechen empfindlicher Oberflächenbereiche, wie u.U. bei der Präparation mittels metallografischen Querschliffs
- Dreifach-Ionenquelle
- Probengröße bis 50x50x10 mm